

全自动汽车芯片选择性波峰焊

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 全自动汽车芯片选择性波峰焊 |
| 公司名称 | 深圳市科圣达超声波自动化设备有限公司 |
| 价格 | 350000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区大浪街道浪口二路92号3楼 |
| 联系电话 | 13823746941 |

产品详情

全自动汽车芯片选择性波峰焊又称机器人焊接，是为了满足通孔元器件焊接发展要求而发明的一种特殊形式的波峰焊。选择焊一般由助焊剂喷涂、预热和焊接三个模块构成。通过设备编程装置，助焊剂喷涂模块可对每个焊点依次完成助焊剂选择性喷涂，经预热模块预热后，再由焊接模块对每个焊点逐点完成焊接。

全自动汽车芯片选择性波峰焊依据模块化的设计理念，使客户完全可以根据其产量和生产品种的变化增加或撤去各个生产单元以满足生产的实际需要。凭借其广泛的研究和生产，丰富的经验，创新能力和雄厚的技术，在波峰的稳定性、波峰高度、防范距离在工业领域应用很广泛。

全自动汽车芯片选择性波峰焊也称选择焊，应用PCB插件通孔焊接领域的设备，因不同的焊接优势，在近年的PCB通孔焊接领域，有逐步成为通孔焊接的流行趋势，应用范围不限于：军工电子、航天轮船电子、汽车电子、数码相机、打印机等高焊接要求且工艺复杂的多层PCB通孔焊接。

全自动汽车芯片选择性波峰焊分为离线式选择性波峰焊和在线式选择性波峰焊两种

离线式选择性波峰焊：离线式即指与生产线脱机的方式，组焊剂喷涂机和选择性焊接机为分体式1+1，其中预热模组跟随焊接部，人工传输，人机结合，设备占用空间较小。

全自动汽车芯片选择性波峰焊实时接收生产线数据全自动对接，组焊剂模组预热模组焊接模组一体式结构，特点是全自动链条传输，设备占用空间较大，适合自动化要求较高的生产模式。

全自动汽车芯片选择性波峰焊与波峰焊主要方式是接触波的大小不一样，选波是点接触，波峰焊小面接触，通过流动锡面来焊接效率会更高一些，但对双面混装板来说高于5MM器件高度，波峰焊就无法实现精焊及拖锡效果了，所以双面混装小批量的大家会选择选择性波峰焊来补充，也公司用来代替铬铁用来补焊（单一产品），如果效果要求高，期待导入价格及运行成本考虑，可以考虑全自动浸锡机
通过治具避焊可实现双面混装产品的量产及代替波峰焊中小批量的生产！

全自动汽车芯片选择性波峰焊特点：

焊接摄像监控系统;可回

喷涂助焊剂:滴喷或雾化喷涂方式;

可按客户要求订制其它功能

全自动汽车芯片选择性波峰焊焊料的快速更换填充系统;

设置焊接角度，减少引脚区域锡桥的产生。

高性价比，控温双重保护，

全自动汽车芯片选择性波峰焊锡炉使用高强度材料，适用有铅、无铅焊接;

可选配电磁泵锡炉

无级调压PID控温，高精度

焊接品质好，透锡接近百分百，彻底解决假焊问题；

锡炉加锡16公斤，氧化量每班0.5公斤；

全自动汽车芯片选择性波峰焊选择性喷雾，节约助焊剂；

选择性焊接，工艺灵活；

每小时耗电两度，电源单相220伏。

大焊板长460mm宽400mm。

全自动汽车芯片选择性波峰焊设备长度两米，电梯可上楼。

无需氮气，也能完美焊接。

焊接时不需要特别的治具、过炉托盘。

通孔零件不需要使用耐Reflow高温的材料。使用一般波焊的条件即可。

焊接时可以获得良好的焊接质量与通孔填充率。

全自动汽车芯片选择性波峰焊节省能源不需要像波峰焊一般有个大锡炉，也不需要回焊炉那么长的加温区即可达到目的。5、节省成本。不需要像波峰焊一样使用过多数量的锡条（Solder Bar）。

避让区比波焊制作过炉托盘来得小。

独创CCD扫描直视编程界面节省时间、生产路径可独立优化提高生产效力、可视化焊接补偿功能为操作者快速完成生产参数导入进行生产。

自定义的喷点大小和速度组合精确控制生产制程适合各种复杂焊接和品质要求

喷流式选择性波峰焊采用全自动在线生产模式,实现自动流水作业,

节省人工手涂助焊剂环节,高效高产能型生产工艺.适合大批量流水生产作业。

双电磁泵选择性波峰焊，双电磁泵锡炉设计且支持升降，实现同台设备两喷嘴焊接工艺。

节能；可离线式编程/Gerber文件导入。

全自动汽车芯片选择性波峰焊品质；透锡度75%以上，锡渣量少

全程显示焊接状态；双面板元件的焊接可实现完全自动化。

采用德国进口滴喷嘴，精度高；

快速便捷的编程系统，无须任何PCB数据，依旧可快速导入数据，且图形编程简易，。

喷雾+预热+焊接模组，完整型一体化设计，适于大批量生产。

全自动汽车芯片选择性波峰焊自主研发的电磁泵，操作方便，维护简单、快捷，相比同行业使用的机械泵波峰更稳定，波峰高度容易控制，波峰均匀性好；焊接喷嘴采用进口特殊材质，经多工序工艺加工、热处理及表面处理，不易氧化，使用寿命长，单个喷嘴使用寿命比同行业能延时30%以上的使用时间；

相比其他选择焊，志胜威选择焊编程时配有视觉对位系统，编程快速；

双面板元件的焊接实现完全自动化。

可离才式编程/Gerber文件导入。

全自动汽车芯片选择性波峰焊无须任何PCB数据。依旧可快速导入数据，且图形编程简易，高效。

采用选择性喷雾，多种算法相结合，精确控制喷雾过程，保证PCB的清洁，

大幅度降低助焊剂的耗量。

分上下独立控温，采用绝灯加热以提高加热效率及温度的均匀性。

波峰喷口移动速度可调，喷头定位；在线监控波峰高度及自动校正功能。

全自动汽车芯片选择性波峰焊焊接过程CCD可视，全程质量跟综。

PCB过板大宽度可达610m

喷雾+预热+焊接模组，完整型一体化设计

双锡炉设计且支持独立升降

可离线式编程/Gerber文件导入

双锡设计且支持独立升降

全自动汽车芯片选择性波峰焊双面板元件的焊接实现完全自动化

波峰喷口移动速度可调

焊接过程CCD可视

全自动汽车芯片选择性波峰焊优势：

较小的设备占地面积

较少的能源消耗

大量的助焊剂节省

大幅度减少锡渣产生

大幅度减少氮气使用量

全自动汽车芯片选择性波峰焊没有工装夹具费用的发生

一体化全功能性机型，整机内部同时有三件PCB板或治具分别在喷雾，预热及焊接处工作，提高机器整体产能。

独立的喷雾运动平台与独立的焊接运动平台。

焊接质量高，大幅提升焊接的直通率。

SMEMA在线运输，支持客户进行灵活组线。

全自动汽车芯片选择性波峰焊全电脑控制，参数均在电脑上设定与保存。生成配置文件，便于追溯与保存